

2026年2月12日星期四

经济要闻

1. 国务院：2月11日，国务院以深化拓展“人工智能+”、全方位赋能千行百业为主题，进行第十八次专题学习。国务院总理李强在主持学习时强调，要全面推进人工智能科技创新、产业发展和赋能应用，培育壮大新质生产力，推动高质量发展。要深刻认识和把握人工智能发展态势，推动人工智能全链条突破、全场景落地，更大释放发展潜能。要持续夯实技术底座，推进算法创新，加大高质量数据供给，提升大模型性能，前瞻布局新技术新路径。要大力推进规模化商业化应用，促进人工智能终端和服务消费，建设人工智能应用中试基地，发展壮大智能体产业，拓展更多高价值应用场景。（资料来源：同花顺）

2. 国务院办公厅：2月11日发布的《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》提出，到2030年，基本建成全国统一电力市场体系，市场化交易电量占全社会用电量的70%左右。到2035年，全面建成全国统一电力市场体系。并着重部署了5方面19项重点任务，包括探索建立容量市场、助力新能源更好参与电力市场、推动更多民营企业参与电力市场等举措。业内人士认为，这一文件针对破除市场壁垒、推动多元主体参与、健全容量保障机制等关键问题加大了攻坚力度，推动全国统一电力市场建设迈入全面深化新阶段，有效带动能源及相关产业提质增效强链，新型储能、虚拟电厂、智能微电网等以民营企业为主的各类新型主体将迎来发展机会。同时，有效稳定社会用能成本，全面提升中国企业在全球的竞争力。（资料来源：同花顺）

3. 中国汽车工业协会：2026年1月，汽车产销分别完成245万辆和234.6万辆，产量同比增长0.01%，销量同比下降3.2%，环比分别下降25.7%和28.3%。汽车行业总体运行平稳，乘用车市场有所下降，商用车市场延续向好态势，新能源汽车市场平稳运行，汽车出口继续保持增长。导致市场下降的主要因素有：一是新能源汽车购置税政策切换调整；二是多地购车补贴政策处于年度交替之际；三是部分消费需求在2025年提前释放。（资料来源：同花顺）

4. 上海期货交易所：发布通知称，经研究决定，根据《上海期货交易所套期保值交易管理办法》第十三条，白银品种各合约自2026年2月最后一个交易日起，未取得临近交割月份套期保值交易持仓额度的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或者客户，其一般月份套期保值交易持仓额度在进入临近交割月份(交割月前一月和交割月份)时，自动转化的临近交割月份买入及卖出套期保值交易持仓额度均暂调整为0手。（资料来源：同花顺）

5. 央行：2月12日以固定利率、数量招标方式开展了1665亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量1665亿元，中标量1665亿元。

本期编辑

分析师：田馨宇

010-66554013

tianxy@dxzq.net.cn

执业证书编号：

S1480521070003

东兴证券研究所金股推荐

证券代码	证券简称
002392.SZ	北京利尔
002991.SZ	甘源食品
300619.SZ	金银河
300627.SZ	华测导航
300666.SZ	江丰电子
300810.SZ	中科海讯
603209.SH	兴通股份
603239.SH	浙江仙通
688095.SH	福昕软件
688627.SH	精智达

数据来源：《二月金股汇》2026年02月02日，东兴证券研究所

同时，以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了 4000 亿元 14 天期逆回购操作。当日 1185 亿元逆回购到期，净投放 4480 亿元。（资料来源：同花顺）

6. 商务部办公厅：发布关于做好 2026 年春节假期消费品以旧换新工作的通知，其中提出，各地要加强春节期间消费品以旧换新补贴资金保障，发挥不同渠道优势，抓好政策实施，更好满足消费需求。顺应春节年俗、增添年味，鼓励消费者走出家门消费购物，2026 年春节 9 天假期内(2 月 15—23 日)，充分保障消费者通过线下渠道申领家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴。对在春节 9 天假期内购买新车的消费者，均可按政策要求申领汽车以旧换新补贴。（资料来源：同花顺）

7. 市场监管总局：发布《汽车行业价格行为合规指南》，进一步规范汽车行业价格行为，促进汽车市场健康重要有序发展。《指南》立足当前汽车行业发展实际，进一步明晰行为边界，统一监管规则，引导汽车生产和销售企业依法合规经营，推动形成优质优价、良性竞争的市场秩序。明确从整车到零部件生产、从定价策略到销售行为各环节的价格合规要求。实行全流程价格管理，强化公平定价约束，规范促销与定价行为，依法打击不正当价格行为。（资料来源：同花顺）

8. 香港：香港特区行政长官李家超表示，香港作为全球 Web3 和加密货币创新中心的地位日益提升。香港金融管理局正在积极处理牌照申请，相信首批稳定币发行机构牌照将于 3 月发出。致力于将香港打造成为数字资产全球创新中心。（资料来源：同花顺）

9. 香港证监会：发布新规，允许持牌虚拟资产经纪在有足够抵押品和投资者保障的情况下，向保证金客户提供虚拟资产融资服务，抵押品仅限比特币和以太币，并设 60% 扣减率。同时，发布高层次框架指导平台开发杠杆式永续合约，仅限专业投资者参与。（资料来源：Wind）

10. 美国：美国劳工统计局发布的就业报告显示，美国 1 月非农就业人口新增 13 万人，远超市场预期。失业率录得 4.3%，创 2025 年 8 月以来新低；时薪环比增长 0.4%，超预期。美国劳工部同时公布，将 2025 年全年就业增长人数由最初报告的 58.4 万大幅下调至 18.1 万，即月均新增就业人数从约 4.9 万降至约 1.5 万，使 2025 年成为不计经济危机所在年份的 2003 年以来就业表现最差一年。在两份数据一强一弱的影响之下，美元走势虽盘中有所波动，但整体偏稳，对金价影响较为有限，市场关注点或转向本周五美国 CPI 数据对降息预期的指引。（资料来源：同花顺）

重要公司资讯

1. 闻泰科技：就荷兰阿姆斯特丹企业法庭针对安世半导体案件做出最新裁决回应，企业法庭并未撤销此前的错误决定，未能解除对安世半导

体实施的临时措施，亦未能恢复闻泰科技作为安世半导体股东的合法控制权。企业法庭同时裁定对安世半导体启动调查程序。公司对这一裁决表示极为失望与强烈不满。（资料来源：同花顺）

2. 江钨装备：公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 188,195.26 万元，扣除发行费用后将用于收购江硬公司 100% 股权、收购华茂公司 100% 股权及收购九冶公司 100% 股权。发行对象为包括公司控股股东江钨控股在内的特定投资者。（资料来源：同花顺）

3. 平治信息：公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 10 亿元，拟用于国产智能算力中心建设项目及补充流动资金。公司控股股东郭庆拟参与本次向特定对象发行认购，拟认购金额不低于 5000 万元且不超过 4 亿元。（资料来源：同花顺）

4. 福赛科技：公司拟向特定对象发行募集资金总额不超过 9.6 亿元，将用于芜湖汽车内饰件智造基地建设项目、泰国生产基地建设项目、核心生产设备数字化迭代改造项目和补充流动资金项目。（资料来源：同花顺）

5. 新锐股份：公司与新乡市慧联电子科技股份有限公司及慧联电子主要股东深圳九日旭投资管理有限公司、徐梅花、李凌祥签署《框架性协议》，公司拟使用不超过 7 亿元向慧联电子主要股东收购其持有的慧联电子 70% 股权，取得其控制权。（资料来源：同花顺）

每日研报**【东兴电子】兴森科技（002436.SZ）：扭亏为盈，AI 驱动 IC 载板涨价潮持续——公司 2025 年业绩预告点评（20260209）**

事件：

2026 年 1 月 30 日，兴森科技发布 2025 年年度业绩预告：预计实现归母净利润 1.32 亿元至 1.40 亿元，大幅扭亏为盈；扣非归母净利润预计为 1.38 亿元至 1.46 亿元。

点评：

公司主营业务盈利能力显著修复，2025 年预计扭亏为盈。2025 年公司预计实现归母净利润 1.32 亿元至 1.40 亿元；扣非归母净利润预计为 1.38 亿元至 1.46 亿元。主要受益于行业复苏，公司营业收入保持稳定增长。利润层面主要受广州兴森半导体有限公司 FCBGA 封装基板业务和宜兴硅谷电子科技有限公司高多层 PCB 业务的影响，其中，FCBGA 封装基板业务仍未实现大批量量产，依然对公司盈利形成拖累，全年费用投入约 6.6 亿元，但 2025 年样品订单数量同比实现大幅增长；高多层 PCB 业务因产品结构不佳，全年亏损约 1 亿元，但各季度亏损持续收窄，第四季度已接近盈亏平衡。

AI 驱动载板高景气，上游刚性涨价，公司稀缺产能价值凸显。AI 服务器需求大爆发，增加对 IC 载板的需求，封装基板产业链的涨价潮已形成刚性传导。智能手机等产品大量使用的 BT 载板率先提价；而用于 CPU、GPU 等高端芯片的 ABF 载板近期也加入涨价行列，其供需缺口高达 21%，价格一年内飙涨 38%。目前来看，ABF 载板供应吃紧情况逐月升温，主要是高阶运算与 AI 应用需求持续扩张，载板需求动能强劲，供给端却难以同步跟上，缺口逐步扩大。产能扩张远跟不上 AI、HPC 驱动的需求爆发。兴森科技作为国内少数既有 BT 载板的布局，又有 ABF 载板的延伸的厂商，其产能和技术能力在此背景下变得尤为稀缺。

全球 IC 载板市场规模在 2025 年达到 166.9 亿美元，预计将在 2026 年增至 184.4 亿美元。IC 载板凭借高密度布线（线宽 $\leq 10\mu\text{m}$ ）、高精度制造等特性，成为支撑 AI 算力升级的关键载体，其技术迭代与市场扩张正形成双向驱动的良好循环。一方面，算力升级需求驱动 IC 载板技术迭代。当下，在 AI 技术浪潮的推动下，AI 芯片（如 GPU/TPU）的算力密度遵循“摩尔定律”式增长，每 18 个月翻倍，对 IC 载板的高密度布线（线宽 $\leq 10\mu\text{m}$ ）和高导热性能（热导率 $\geq 5\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$ ）提出更高要求。随着 AI 芯片、高性能计算（HPC）及 5G 通信等领域的爆发式增长，IC 载板市场需求将持续攀升，行业步入新一轮成长期。全球 IC 载板市场规模在 2025 年达到 166.9 亿美元，预计将在 2026 年增至 184.4 亿美元，并最终在 2035 年扩张至 453.4 亿美元。该市场预计在 2026 年至 2035 年的整个预测期内，将以 10.51% 的强劲复合年增长率（CAGR）增长。

公司盈利预测及投资评级：公司是国内既有 BT 载板的布局，又有 ABF 载板的延伸的厂商，受益于 AI 浪潮，PCB 业务和半导体业务持续发力。预计 2025-2027 年公司 EPS 分别为 0.08 元，0.25 元和 0.40 元，维持“推荐”评级。

风险提示：（1）下游需求放缓；（2）业务拓展不达预期；（3）贸易摩擦加剧。

(分析师：刘航 执业编码：S1480522060001 电话：021-25102913 研究助理：李科融 执业编码：
S1480124050020 电话：021-65462501)

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与，未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

风险提示

本证券研究报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。在任何情况下，本公司证券研究报告均不构成对任何机构和个人的投资建议，市场有风险，投资者在决定投资前，务必要审慎。投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。

免责声明

以上内容来源于东兴证券研究报告的观点。

本研究报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写，东兴证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。本研究报告中所引用信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

我公司及报告作者在自身所知情的范围内，与本报告所评价或推荐的证券或投资标的的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为东兴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本研究报告仅供东兴证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用，未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告、防止被误导，本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授权客户使用该报告所产生的相关风险和责任。

行业评级体系

公司投资评级（A股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数）：

以报告日后的 6 个月内，公司股价相对于同期市场基准指数的表现为标准定义：

强烈推荐：相对强于市场基准指数收益率 15% 以上；

推荐：相对强于市场基准指数收益率 5%~15% 之间；

中性：相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5% 之间；

回避：相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上。

行业投资评级（A股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数）：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准指数的表现为标准定义：

看好：相对强于市场基准指数收益率 5% 以上；

中性：相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5% 之间；

看淡：相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上。